

# 한화

## 저밀도 폴리에틸렌

# 5325

블로운 필름용 제품

용융지수 4.0

밀도 0.923

한화 LDPE 5325 의 주용도는 일반 포장용 필름이며 가공성, 기계적 물성이 우수한 제품입니다.  
한화 LDPE 5325 는 미국 FDA 의 21 CFR 177.1520 (c) 2.1. 규정에 적합한 제품입니다.

### ▣ 제품 특징

가공성  
기계적물성

### ▣ 적정 가공 조건

가공 온도 : 140 ~ 170℃  
팽창비 : 2 ~ 3  
두께 : 25 ~ 100 μm

### ▣ 첨가제

### ▣ 제품 물성

수지 물성	단위	시험 방법	대표값
용융지수	g/10 분	ASTM D1238	4.0
밀도	g/cc	ASTM D1505	0.923
Vicat 연화점	℃	ASTM D1525	87
용융점	℃	ASTM D2117	111
인장강도(파단점)	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D638	115
연신율(파단점)	%	ASTM D638	650
필름 물성	단위	시험방법	대표값
두께	mm	HCC 방법	0.03
인장강도(파단점), 세로/가로	kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D882	220/170
인장인열강도, 세로/가로	kg/cm	ASTM D1004	90/80
연신율(파단점), 세로/가로	%	ASTM D882	300/550
낙하충격강도	g	ASTM D1709	60
흐림도	%	ASTM D1009	6.0
45° 광택도	%	ASTM D2457	75

※ 필름 압출기 사양 및 가공 조건:

- 40mmφ LLD/LD 겸용 스크류, 75mmφ 다이, 1.5mm 다이갭, 듀얼립 에어링
- 가공온도(호퍼부~다이부) 150 ~ 170℃, 팽창비 2

1. 상기의 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
2. 상기 특성치는 기기특성이나 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

